

發明專利說明書

(本說明書格式、順序及粗體字，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

※ 申請案號：95143604

※ 申請日期：95.11.24.

※IPC 分類：H01L²⁷/₁₄、²³/₀₀

一、發明名稱：(中文/英文)

薄型影像晶片封裝結構

12506.01

二、申請人：(共 1 人)

姓名或名稱：(中文/英文)

台灣沛晶股份有限公司

代表人：(中文/英文)(簽章) 吳 澄 郊

住居所或營業所地址：(中文/英文)

新竹縣竹北市中華路 676 巷 16 號

國 籍：(中文/英文) 中華民國

三、發明人：(共 1 人)

姓 名：(中文/英文)

吳 澄 郊

國 籍：(中文/英文)

中華民國

四、聲明事項：(略)

九、發明說明：

【發明所屬之技術領域】

本發明係與晶片封裝結構有關，更詳而言之是指一種薄型影像晶片封裝結構。

5 【先前技術】

按，以習知之積體電路晶片構裝而言，一般係直接將一晶片貼接於一電路板上，再利用金屬導線焊接至該晶片之焊墊及電路板上，使該晶片可藉由該金屬導線之連接而與該電路板呈電性之連通。

10 惟，當其構裝之晶片為一種攝取影像用之晶片時，該晶片之頂面乃為一影像感測區，以藉由該影像感測區加以成像，因此該影像感測區須為極度之乾淨，但由於在構裝之加工過程中，仍必須有焊接導線…等之作業，因此極易造成影像感測區有污染物濺佈之情形發生，而導致成像之
15 效果不佳，或更甚有因焊接導線之不慎而誤撞擊影像感測區之情形，進而造成損壞。

再者，由於影像用晶片之構裝必須再藉由一封裝體直接將整個晶片加以包覆，但受限於導線之焊接及避免有誤觸影像感測區之情形，而必須將其封裝體設置於距該晶片
20 有一預定距離之位置上，此對現今要求輕薄短小之晶片構裝而言，無疑不符現今之時勢。

【發明內容】

有鑑於此，本發明之主要目的乃在提供一種薄型影像

晶片封裝結構，係可有效減少整體構裝後之體積者。

本發明之另一目的乃在提供一種薄型影像晶片封裝結構，係可避免其影像感測區於施打導線時受到污染或損傷者。

5 緣是，為達上述目的，本發明所提供一種薄型影像晶片封裝結構，包含有：一載體；一影像晶片，係以其一端
面連結於該載體上，該影像晶片之另一端上形成有一影像
感測區，並於該影像感測區之外周邊上形成有若干之晶片
10 焊墊；一罩體，具有一連接部及一頂罩部，該連接部係連
結於該影像晶片上，並位於該影像感測區與該晶片焊墊之
間，使由該連接部加以阻隔於該影像感測區與該晶片焊墊
之間，該頂罩部係連結於該連接部上，並位於該影像感測
15 區之上方；若干之導線，係以其一端連接於該晶片焊墊上，
另一端則連接於該載體上，使該影像晶片與該載體間藉由
該導線而電性連通；一蓋體，具有一側壁及一頂板，該側
壁係連接於該載體上，該頂板係連接於該側壁上，且該頂
板形成有一穿孔，使該頂罩部位於該穿孔中，而與外界相
通，且該頂板係可將該導線完全蓋覆。

20 【實施方式】

為使貴 審查委員，能對本發明之特徵及目的有更進一步之瞭解與認同，茲列舉以下較佳之實施例，並配合圖式說明於後：

請參閱第一及第二圖，係本發明第一較佳實施例所提

供一種薄型影像晶片封裝結構(10)，其主要包含有一載體(11)、一影像晶片(12)、一罩體(13)、若干之導線(14)、一蓋體(15)及一黏著物(16)；其中：

該載體(11)，係可為塑膠、強化塑膠、玻璃纖維、陶瓷…等材質所製成之電路板或花架預鑄(Printed Circuit Board、PCB、PRE-MOLD)，作為該封裝結構(10)與外界電性連接之橋樑；該載體(11)呈一平板狀，具有一頂面(111)及一與該頂面(111)相背之底面(112)，該頂面(111)上佈設有呈預定態樣及數量之電路佈線(圖中未示)及若干與該電路佈線電性相通之電路焊墊(113)。

該影像晶片(12)，具有一頂面及一與該頂面相背之底面，其底面係藉由環氧樹脂、矽樹脂、低熔點之玻璃或雙面膠帶…等黏性材料，而黏著貼附於該載體(11)之頂面(111)上，該影像晶片(12)之頂面中央位置處設置有一影像感測區(121)用以成像，並於影像晶片(12)之頂面上位於該影像感測區(121)之外部周邊處，設置有若干與該影像晶片(12)呈電性導通之晶片焊墊(122)。

該罩體(13)，包含有一連接部(131)及一頂罩部(132)；該連接部(131)於本實施例中為一軸心呈透空狀之環形體，係可由塑膠、玻璃、玻璃纖維、金屬或陶瓷…材質所製成，使其軸心內部形成一罩設空間(133)，該連接部(131)係以其一端緣(底緣)藉由一黏膠(圖中未示)而連接抵於該影像晶片(12)頂面之影像感測區(121)周圍外，且係連接於該影像感測區(121)與該各晶片焊墊(122)之間，使該影像感測區

(121)位在該罩設空間(133)內，而由該連接部(131)將該影像感測區(121)之外周邊加以封閉，並使得該晶片焊墊(122)與該影像感測區(121)得以由該連接部(131)而加以隔開，該連接部(131)外側邊上並再以一快乾膠(134)黏接於該影像晶片(12)上，以迅速固定該連接部(131)與該影像晶片(12)之相關位置；該頂罩部(132)於本實施例中為一絕緣之圓盤狀薄板(亦可為矩形狀薄板)，係可由玻璃等透光材料所製成，該頂罩部(132)係藉由一黏著物(圖中未示)而黏接於該連接部(131)之另一端緣(頂緣)上，使該頂罩部(132)正位於該影像感測區(121)之上方，並藉由與該連接部(131)之連接而距該影像感測區(121)有一預定之距離，使由該頂罩部(132)將該罩設空間(133)之上方加以封閉；於本實施例中，該頂罩部(132)之寬度面積係相等於該連接部(131)之寬度面積，但於實際設計時，該頂罩部之寬度面積亦可大於該連接部之寬度面積。

該等導線(14)，係由黃金、鋁…等導電金屬材質所製成，係利用打線技術將該各導線(14)分別與該載體(11)之電路焊墊(113)及該晶片(12)之晶片焊墊(122)電性連接；於打線作業時，該導線(14)首先以垂直該載體(11)電路焊墊(113)之方式與該電路焊墊(113)牢固地銜接(為第一焊接點)，再將導線(14)往上拉伸至晶片(12)頂面之位置時，以近乎水平之方式延伸至與該晶片焊墊(122)銜接(為第二焊接點)，藉此，該晶片(12)上方供導線(14)容置之空間即可加以扁平化而大幅縮減封裝結構(10)之高度。

該蓋體(15)，係可由一不透明之塑膠、玻璃纖維、金屬、陶瓷或透明之玻璃、石英、塑膠材質所製成；該蓋體(15)具有一側壁(151)及一頂板(152)，該側壁(151)於本實施例中為一軸向呈透空狀之矩形體(亦可為環形體)，使其軸向內部形成一蓋設空間(153)，該側壁(151)係以其一端緣(底緣)藉由一黏著物(圖中未示)而連接於該載體(11)之頂面(111)上，且係位於該電路焊墊(113)之外周圍，使該晶片(12)、電路焊墊(113)及各導線(14)皆位在封裝之蓋設空間(153)內，該頂板(152)於本實施例中為一矩形狀薄板(亦可為環形狀薄板)，該頂板(152)係以其外側緣連接於該側壁(151)之另一端緣(頂緣)，且該頂板(152)中央位置並形成有一穿孔(154)，該穿孔(154)之孔徑略大於該罩體(13)之頂罩部(132)外徑，使該頂罩部(132)正位於該穿孔(154)中，且該頂板(152)係可將該導線(14)完全蓋覆。

該黏著物(16)，可為矽樹脂(Silicones)、環氧樹脂(Epoxyes)、丙烯酸樹脂(Acrylics)、聚醯亞胺(Polyamides)、低熔點之玻璃…等材質所製成，該黏著物(16)係佈設於該罩體(13)頂罩部(132)之外側與該蓋體(15)之穿孔(154)之內壁面間，使該罩體(13)與該蓋體(15)加以黏接，以將該晶片(12)及導線(14)加以封閉於該蓋體(15)之蓋設空間(153)內，而完成整體之封裝作業。

由於本發明之封裝結構(10)於進行打線作業(即將導線與晶片焊墊及電路焊墊連接之作業)前，已藉由該罩體(13)將影像感測區(121)與晶片焊墊(122)加以阻隔，可避免於打

線作業時有誤觸或污染影像感測區(121)之情事發生。另外，由於導線(14)係以近乎水平之方式延伸至與該晶片焊墊(122)銜接，因此，該晶片(12)上方供導線(14)容置之空間即可加以扁平化而大幅縮減封裝結構(10)之高度。

5 再者，該罩體(13)之連接部(131)與頂罩部(132)亦可採一體成形所製成，而該蓋體(15)之側壁(151)與該頂板(152)亦可採一體成形所製成，可更加簡化整體組裝之作業。

請參閱第三圖，係本發明第二較佳實施例所提供之一種薄型影像晶片封裝結構(20)，其與上述實施例相同包含有
10 一載體(21)、一影像晶片(22)、一罩體(23)、若干之導線(24)、一蓋體(25)及一黏著物(26)，惟與上述實施例之差異在於：

該蓋體(25)之蓋設空間(253)內更佈設有一包覆體(27)，係覆蓋於該晶片(22)及該導線(24)上，該包覆體(27)係可為矽樹脂(Silicones)、環氧樹脂(Epoxies)、丙烯酸樹脂
15 (Acrylics)、聚醯亞胺(Polyamides)、低熔點之玻璃…等材質所製成，該包覆體(27)於初期係呈膠狀，而後可乾燥固化成硬質之保護體，藉以保護該晶片(22)及該導線(24)。

請參閱第四圖，係本發明第三較佳實施例所提供之一種薄型影像晶片封裝結構(30)，其與第一較佳實施例相同包
20 含有一載體(31)、一影像晶片(32)、一罩體(33)、若干之導線(34)、一蓋體(35)及一黏著物(36)，惟與第一較佳實施例之差異在於：

該導線(34)，係以其一端焊接於該晶片(32)之晶片焊墊(322)上，再將另一端焊接於該載體(31)之頂面(311)上，且

該導線(34)係由其一端與載體(31)焊接後，而逐漸地呈往晶片(32)中心之方向傾斜地拉伸至由另一端與該晶片焊墊(322)焊接，如此一來，該導線(34)便呈傾斜狀，雖其導線(34)所佔之空間較大，但卻較便於打線之作業者。

5 該蓋體(35)之側壁(351)鄰近於與該載體(31)頂面(311)連接之內側部位上，形成有一容置空間(355)，該容置空間(355)係用以供鄰近於載體(31)之導線(34)部位容置，即形成該容置空間(355)之側壁(351)其厚度較薄，且呈現與該導線(34)同一走向之斜切態樣。如此一來，原本為便於打線作業
10 而將該導線(34)呈斜接狀態所增加之耗佔空間，即可由該導線(34)置位於該容置空間(355)內所加以補償，使得蓋體(35)之整體高度及寬度皆無需增加，而可同樣使封裝結構(30)呈薄型化，而能減少打線作業之進行難度及增進打線作業之效率。

15 請參閱第五圖，係本發明第四較佳實施例所提供之一種薄型影像晶片封裝結構(40)，其與第一較佳實施例相同包含有一載體(41)、一影像晶片(42)、一罩體(43)、若干之導線(44)、一蓋體(45)及一黏著物(46)，惟與第一較佳實施例之差異在於：

20 該蓋體(45)更於其頂板(452)上凸伸形成有一容置部(456)，該容置部(456)內部係呈上下透空而形成有一容室(457)，該容室(457)並與該穿孔(454)連通，該容室(457)之內側壁面上形成有一第一螺紋部(458)，該第一螺紋部(458)為一內螺紋。

該薄型影像晶片封裝結構(40)更包含有一鏡頭(47)，該鏡頭(47)具有一管體(471)及若干固設於該管體(471)內之鏡片(472)，該管體(471)之外周面上設有一第二螺紋部(473)，該第二螺紋部(473)為一外螺紋，係螺接於該蓋體(45)之第一螺紋部(458)上，使可藉由旋轉該管體(471)以造成該鏡頭(47)之上、下位移，以調整鏡頭(47)中之鏡片(472)焦距。

請參閱第六圖，係本發明第五較佳實施例所提供之一種薄型影像晶片封裝結構(50)，其與第一較佳實施例相同包含有一載體(51)、一影像晶片(52)、一罩體(53)、若干之導線(54)、一蓋體(55)及一黏著物(56)，惟與第一較佳實施例之差異在於：

該罩體(53)之頂罩部(532)為一鏡片，係貼接於該連接部(531)上，使該頂罩部(532)正位於該影像感測區(521)之上方，並藉由與該連接部(531)之連接，而使得該頂罩部(532)與該影像感測區(521)間距有一預定之距離，使可由該頂罩部(532)提供聚焦之效果。

該蓋體(55)更於其頂板(552)上凸伸形成有一容置部(556)，該容置部(556)內部係呈上下透空而形成有一容室(557)，該容室(557)並與該穿孔(554)連通，該容室(557)內則固設置有一鏡片(559)。

當然，該頂罩部(532)可為與該連接部(531)所一體製成，而該鏡片(559)亦可與該容置部(556)所一體製成。

請參閱第七圖，係本發明第六較佳實施例所提供之一種薄型影像晶片封裝結構(60)，其與第一較佳實施例相同包

含有一載體(61)、一影像晶片(62)、一罩體(63)、若干之導線(64)、一蓋體(65)及一黏著物(66)，惟與第一較佳實施例之差異在於：

該載體(61)之頂面(611)上以一預定之寬度及深度向下
5 凹陷延伸有一凹陷區(614)，該影像晶片(62)係設置於該凹陷區(614)內，該各導線(64)則係利用打線技術將其兩端分別連接於該影像晶片(62)之晶片焊墊(622)及該載體(61)頂面(611)上之電路焊墊(圖中未示)上。

該蓋體(65)僅具有一頂板(652)且藉由一可撕離性之黏
10 性體(651)以其一面黏貼於該載體(61)之頂面(611)上，使該罩體(63)之頂罩部(632)同樣位於該蓋體(65)之穿孔(654)中，且同樣由該黏著物(66)將該蓋體(65)與該罩體(63)加以黏結。

另外，該黏性體(651)亦可為多數個之黏性體，係採用
15 多點方式黏貼於該載體(61)之頂面(611)上。如此一來，不僅可達成本發明之目的，更可藉由該黏性體易撕離之特性，將該蓋體(65)與該載體(61)分離使封裝內部維修更為簡易。

雖然於本實施例中，該載體之電路焊墊係設置於其頂
20 面上，但實際上亦設置於該凹陷區中，而使得整體之封裝結構可更加地降低高度。

【圖式簡單說明】

第一圖係本發明第一較佳實施例之剖視示意圖。

第二圖係第一圖所示較佳實施例之頂面示意圖。

第三圖係本發明第二較佳實施例之剖視示意圖。

5 第四圖係本發明第三較佳實施例之剖視示意圖。

第五圖係本發明第四較佳實施例之剖視示意圖。

第六圖係本發明第五較佳實施例之剖視示意圖。

第七圖係本發明第六較佳實施例之剖視示意圖。

10 【主要元件符號說明】

「第一較佳實施例」

薄型影像晶片封裝結構(10)

載體(11)

頂面(111)

底面(112)

電路焊墊(113)

15 影像晶片(12)

影像感測區(121)

晶片焊墊(122)

罩體(13)

連接部(131)

頂罩部(132)

罩設空間(133)

快乾膠(134)

導線(14)

蓋體(15)

20 側壁(151)

頂板(152)

蓋設空間(153)

穿孔(154)

黏著物(16)

「第二較佳實施例」

薄型影像晶片封裝結構(20)

- 載體(21) 影像晶片(22)
- 罩體(23) 導線(24)
- 蓋體(25) 蓋設空間(253)
- 黏著物(26) 包覆體(27)
- 5 「第三較佳實施例」
- 薄型影像晶片封裝結構(30)
- 載體(31) 頂面(311)
- 影像晶片(32) 晶片焊墊(322)
- 罩體(33) 導線(34)
- 10 蓋體(35) 側壁(351)
- 容置空間(355) 黏著物(36)
- 「第四較佳實施例」
- 薄型影像晶片封裝結構(40)
- 載體(41) 影像晶片(42)
- 15 罩體(43) 導線(44)
- 蓋體(45) 頂板(452)
- 容置部(456) 容室(457)
- 穿孔(454) 第一螺紋部(458)
- 黏著物(46) 鏡頭(47)
- 20 管體(471) 鏡片(472)
- 第二螺紋部(473)
- 「第五較佳實施例」
- 薄型影像晶片封裝結構(50)
- 載體(51) 影像晶片(52)

	影像感測區(521)	罩體(53)
	連接部(531)	頂罩部(532)
	導線(54)	蓋體(55)
	頂板(552)	容置部(556)
5	容室(557)	穿孔(554)
	鏡片(559)	黏著物(56)
	「第六較佳實施例」	
	薄型影像晶片封裝結構(60)	
	載體(61)	頂面(611)
10	凹陷區(614)	影像晶片(62)
	晶片焊墊(622)	罩體(63)
	頂罩部(632)	導線(64)
	蓋體(65)	黏性體(651)
	頂板(652)	穿孔(654)
15	黏著物(66)	

五、中文發明摘要：

薄型影像晶片封裝結構

一種薄型影像晶片封裝結構，包含有一載體、一影像晶片、一罩體及若干之導線；該影像晶片係以其一端面連結於該載體上，該影像晶片之另一端上形成有一影像感測區，並於該影像感測區之外周邊上形成有若干之晶片焊墊；該罩體具有一連接部及一頂罩部，該連接部係連結於該影像晶片上，並位於該影像感測區與該晶片焊墊之間，使由該連接部加以阻隔於該影像感測區與該晶片焊墊之間，該頂罩部係連結於該連接部上，並位於該影像感測區之上方；該等導線係以其一端連接於該晶片焊墊上，另一端則連接於該載體上，使該影像晶片與該載體間藉由該導線而電性連通；該蓋體具有一側壁及一頂板，該側壁係連接於該載體上，該頂板係連接於該側壁上，且該頂板形成有一穿孔，使該頂罩部位於該穿孔中而與外界相通，且該頂板係可將該導線完全蓋覆。

六、英文發明摘要：

十、申請專利範圍：

1. 一種薄型影像晶片封裝結構，包含有：

一載體；

一影像晶片，係以其一端面連結於該載體上，該影像晶片之另一端上形成有一影像感測區，並於該影像感測區之外周邊上形成有若干之晶片焊墊；

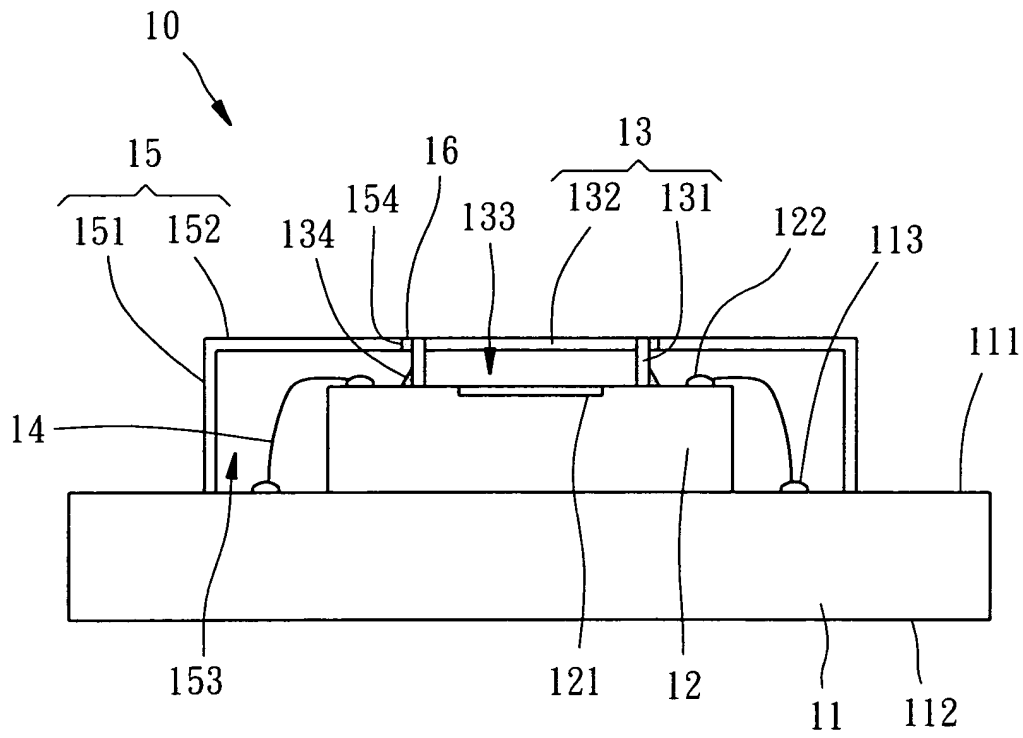
一罩體，具有一連接部及一頂罩部，該連接部係連結於該影像晶片上，並位於該影像感測區與該晶片焊墊之間，使由該連接部加以阻隔於該影像感測區與該晶片焊墊之間，該頂罩部係連結於該連接部上，並位於該影像感測區之上方；

若干之導線，係以其一端連接於該晶片焊墊上，另一端則連接於該載體上，使該影像晶片與該載體間藉由該導線而電性連通；

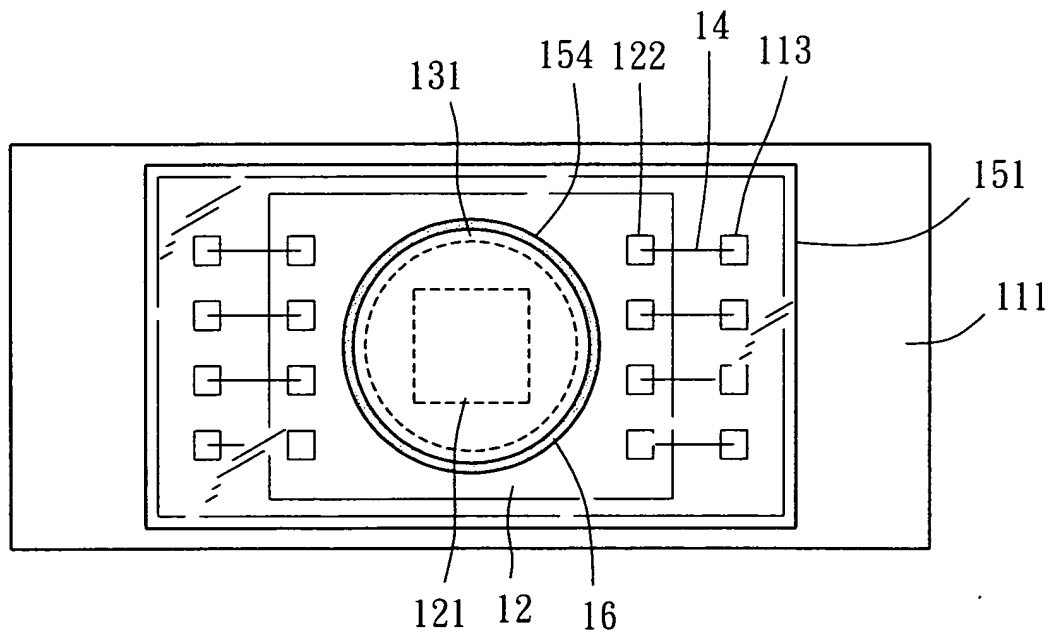
一蓋體，係連接於該載體上用以封裝晶片及各導線，並具有一頂板，且該頂板形成有一穿孔，使該頂罩部位於該穿孔中，而與外界相通，且該頂板係可將該導線完全蓋覆。

2. 依據申請專利範圍第 1 項所述薄型影像晶片封裝結構，其中更包含有一黏著物，係設於該罩體之外側與該蓋體之穿孔間，以黏接該罩體之頂罩部與該蓋體之頂板。

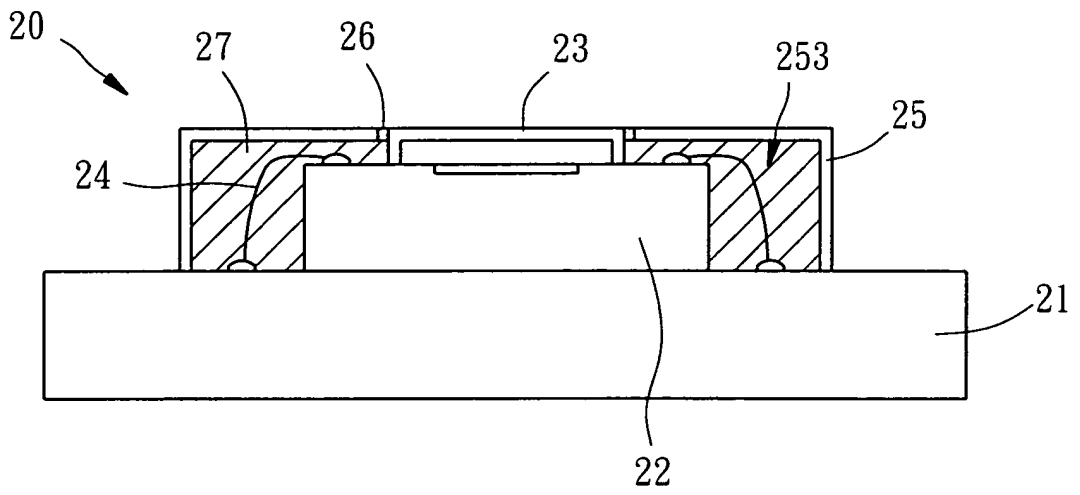
3. 依據申請專利範圍第 1 項所述薄型影像晶片封裝結構，其中該載體具有一頂面及一與該頂面相背之底面，該頂面上佈設有呈預定態樣及數量之電路佈線及若干與該電路佈線電性相通之電路焊墊；該影像晶片係連結於該頂面



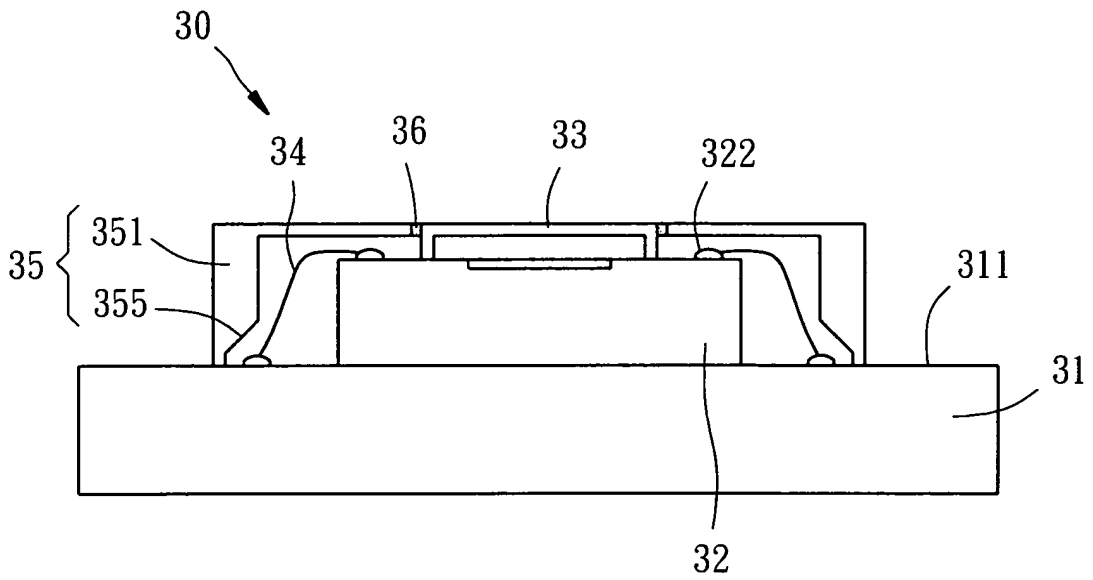
第一圖



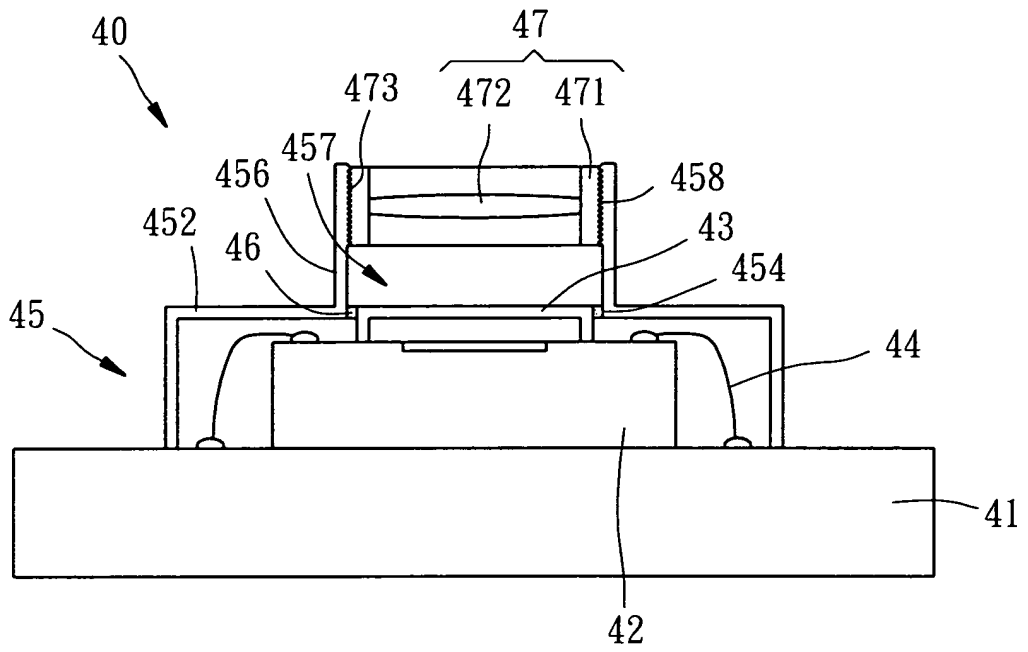
第二圖



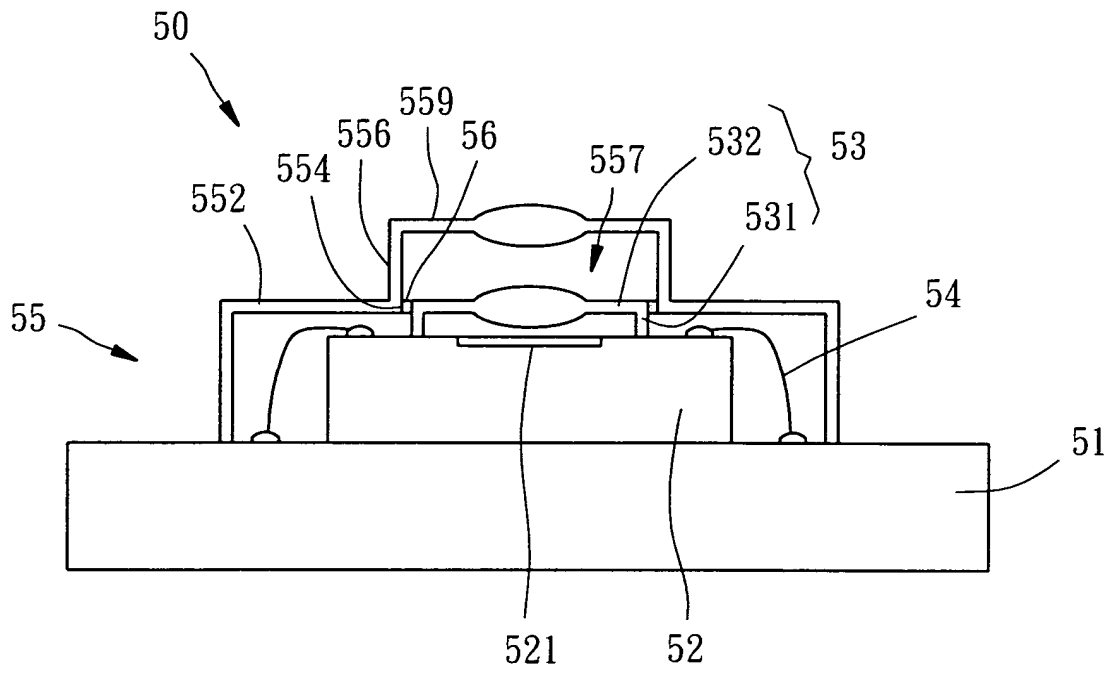
第三圖



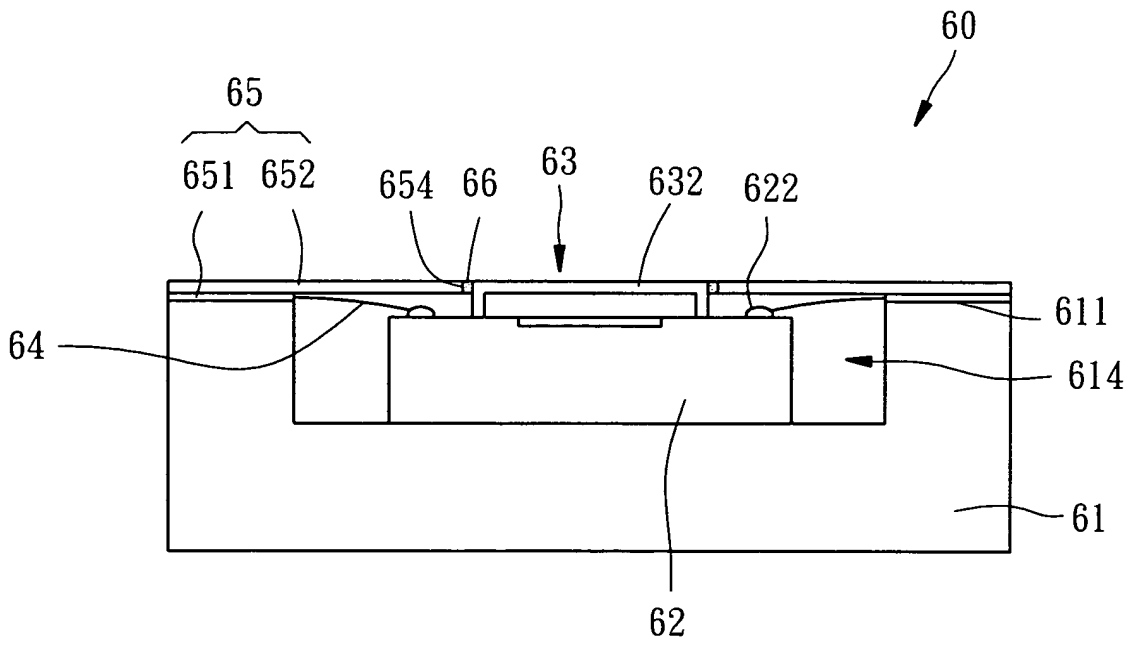
第四圖



第五圖



第六圖



第七圖

七、指定代表圖：

(一)本案指定代表圖為：第(一)圖。

(二)本代表圖之元件符號簡單說明：

薄型影像晶片封裝結構(10)

載體(11)

頂面(111)

5 底面(112)

電路焊墊(113)

影像晶片(12)

影像感測區(121)

晶片焊墊(122)

罩體(13)

連接部(131)

頂罩部(132)

罩設空間(133)

快乾膠(134)

10 導線(14)

蓋體(15)

側壁(151)

頂板(152)

蓋設空間(153)

穿孔(154)

黏著物(16)

八、本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徵的化學式：

98年11月27日(第3次)正替換頁

上，該等導線係電性連接於該電路焊墊與該晶片焊墊上。

4.依據申請專利範圍第 1 項所述薄型影像晶片封裝結構，其中該載體具有一頂面及一與該頂面相背之底面，該頂面上凹陷有一凹陷區，該頂面上佈設有呈預定態樣及數量之電路佈線及若干與該電路佈線電性相通之電路焊墊；
5 該影像晶片係設置於該凹陷區內，該等導線係電性連接於晶片焊墊及電路焊墊上。

5.依據申請專利範圍第 1 項所述薄型影像晶片封裝結構，其中該連接部係由塑膠、玻璃、玻璃纖維、金屬或陶
10 瓷所製成。

6.依據申請專利範圍第 1 項所述薄型影像晶片封裝結構，其中該連接部內形成一罩設空間，該影像感測區係位在該罩設空間內。

7.依據申請專利範圍第 1 項所述薄型影像晶片封裝結構，其中該頂罩部係由透光材質製成。
15

8.依據申請專利範圍第 1 項所述薄型影像晶片封裝結構，其中該導線係以垂直該載體之方式連接於該載體上，並以近乎水平之方式與該晶片焊墊連接。

9.依據申請專利範圍第 1 項所述薄型影像晶片封裝結構，其中該蓋體更設有一側壁，該側壁為一軸向呈透空狀之形體，其內部形成一蓋設空間，該側壁係以其一端緣連接於該載體上，而以另一端緣連接於該頂板上。
20

10.依據申請專利範圍第 9 項所述薄型影像晶片封裝結構，其中該側壁與該頂板係由一體製成。

11.依據申請專利範圍第 9 項所述薄型影像晶片封裝結構，其中該導線係由與載體連接之一端，逐漸地往晶片中心之方向呈傾斜狀態；該側壁之內側形成有一容置空間，用以供導線容置。

5 12.依據申請專利範圍第 11 項所述薄型影像晶片封裝結構，其中形成該容置空間之側壁其厚度較薄。

13.依據申請專利範圍第 1 項所述薄型影像晶片封裝結構，其中該連接部與頂罩部係由一體製成。

10 14.依據申請專利範圍第 1 項所述薄型影像晶片封裝結構，其中該蓋體內設有一包覆體，係覆蓋於該影像晶片及該導線上。

15 15.依據申請專利範圍第 1 項所述薄型影像晶片封裝結構，其中該頂板上具有一容置部，該容置部形成有一容室，該容室係與該穿孔連通；該薄型影像晶片封裝結構更包含有一鏡頭，該鏡頭係設置於該容室中。

16.依據申請專利範圍第 15 項所述薄型影像晶片封裝結構，其中該容室之內側壁面上形成有一第一螺紋部；該鏡頭外側形成有一第二螺紋部，該第二螺紋部係與該第一螺紋部螺接。

20 17.依據申請專利範圍第 15 項所述薄型影像晶片封裝結構，其中該容室內設有一內螺紋；該鏡頭具有一管體及若干固設於該管體內之鏡片，該管體外周上設有一外螺紋，係與該內螺紋螺接，使該鏡頭可相對該容室作上、下之位移。

98年11月27日(正)正替換頁

18.依據申請專利範圍第 1 項所述薄型影像晶片封裝結構，其中該頂罩部為一鏡片。

19.依據申請專利範圍第 1 項所述薄型影像晶片封裝結構，更包含有一可撕離性的黏性體，係位於該蓋體與該載
5 體之間。

20.依據申請專利範圍第 1 項所述薄型影像晶片封裝結構，其中該黏性體以多點方式黏貼。

21.依據申請專利範圍第 1 項所述薄型影像晶片封裝結構，其中該連接部係藉由一黏膠而連接於該影像晶片上。

10 22.依據申請專利範圍第 1 項所述薄型影像晶片封裝結構，其中更由一快乾膠黏接於連接部之外側邊及該影像晶片上，以迅速固定該連接部與該影像晶片之相關位置。